

# 전자부품산업의

## 육성 및 수출증대 방안(Ⅲ)

(본회 부품산업과)

### 목 차

#### Ⅵ. 전자부품산업의 육성 및 수출증대 방안

##### 1. 종합대책

##### 2. 주요 품목별 수출동향 및 촉진대책

#### Ⅵ-2. 주요 품목별 수출 동향 및 촉진대책

##### 1. CRT

###### 1) 세계시장 동향

LCD 출현에도 불구하고 세계 CRT 시장은 '98년에 1.6%(수량은 4.6%) 증가에서 '99년에는 1.7%(수량은 5.4%) 증가하는 등 지속적으로 증가추세에 있다. 품목별로는 CPT의 수요는 정체된 상태로써, CDT 중심으로 성장하고 있으며 주목할 만한 것은 CPT의 세계 최대 시장은 중국(전체의 18%)이라는 점이다.

###### 2) 경쟁국 동향

일본은 와이드 TV용 CPT와 중형 CDT를 중심으로 평면 브라운관, 고선명 CDT 개발에 주력하고 있다.

업계조사에서 나타난 가격 경

쟁력은 다음과 같다.

- 소형 CPT(14")는 중국대비 열세(한국:100, 중국:82)
- 대형 CPT(25")는 일본대비 다소 우위(한국:100, 일본:105)
- 소형 CDT(14")는 대만보다 열세(한국:100, 대만:95)
- 대형 CDT(17")는 일본과 대등(한국:100, 일본:100)

###### 3) 단기 수출촉진 대책

중형이상 CDT는 일본과의 격차가 없으므로 원가절감 노력 등으로 가격 경쟁력을 높이고 국내 업계간 과장경쟁 지양하여 수출단가가 낮아지는 것은 막는 것이 중요하다.

수출용 모니터에도 국산채용을 확대할 수 있도록 하고 평면 브라운관 및 고선명 CDT 등 신기술 개발 및 채용촉진도 필요하다.

###### 4) 수출동향 및 전망(표 1)

(표 1)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	2,187	2,137	2,210	2,350	-2.3	2.4	
지역별	미국	15	14	15	16	-6.7	3.4
	유럽	184	198	200	230	2.1	3.8
	일본	182	91	147	160	-50.0	15.2
	아세아	762	705	753	820	-7.5	3.8
	기타	1,034	1,129	1,095	1,124	9.2	-1.1

자료 : EIAK

## 2. LCD

### 1) 세계시장 동향

세계시장은 '98년에는 20.7% 증가하고 '99년에는 21.1% 증가할 것으로 예상되는 등 지속적인 고성장이 예상된다.

특히 TFT-LCD의 경우 '98년에 31.1% 증가, '99년에는 30.5% 증가하여 LCD의 주종이 되고 있다.

규격 면에서는 노트북 컴퓨터의 호조로 12.1"가 전체의 48.8%를 차지한다.

### 2) 경쟁국 동향

일본이 세계 전체 시장의 80% 점유하고 있으나 한국, 대만 등의 공급으로 점유율은 점차 저하될 것으로 기대된다.

공급이 확대되면서 가격이 급락하여 12.1" TFT-LCD의 경우 '97년 \$600이던 것이 '98년(10월 현재) \$300~\$350로 낮아졌다.

일본은 대형(40")화, 시야각

확대 (140°), 다결정 Si TFT 등 신기술 개발에 주력하고 있다.

### 3) 단기 수출촉진 대책

수출(일본:85%, 한국:60%) 제고를 위한 공정기술 개발이 필요하며 원·부자재 국산화(일본:100%, 한국:10~20%)를 통하여 부가가치를 높이고 가격 경쟁력도 향상시킬 필요가 있다. 생산시설을 확충하는 등 공급 능력을 확대가 시급하며 대만, 유럽시장 등으로 시장을 헤나가야 한다.

## 4) 수출동향 및 전망 (표 2)

## 3. PCB

### 1) 세계시장 동향

세계시장은 '98년에 7.4%, '99년에는 8.0% 성장할 것으로 전망된다.

가전의 영향이 큰 단면(혹은 양면)제품은 과거 C-TV나 VCR 특수와 같은 대량 신규 수요가 발생하지 않는 한 주요 영상 기기의 내수, 수출부진, 가전업계의 해외생산 가속화, 대체 가전의 양면 및 MLB화 등으로 앞으로도 수요가 완만한 하강곡선을 그리며 퇴조할 것으로 보인다.

MLB, MCM 등의 경우 컴퓨터 메인보드와 정보통신시스템 단말기의 고성장에 힘입어 고성장이 거듭되고 있는데 앞으로 경박단소형 및 휴대형 이동통신기기의 잇따른 출현으로 보다 다층화, 고밀도화, 초박판

(표 2)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	702	815	980	1,270	16.1	11.7	
지역별	미국	122	71	130	220	-41.8	32.7
	유럽	85	149	147	185	75.3	5.6
	일본	225	83	214	264	-63.1	33.6
	아세아	263	502	477	560	90.9	2.8
	기타	7	10	12	41	42.9	42.3

자료 : EIAK

화 되면서 부가가치를 높여 연평균 두 자릿수의 고성장이 예상된다.

## 2) 경쟁국 동향

플러터디브공법에 의한 IVH, BVH, SVH 등의 고밀도기판, pre-impregnated에 교대하여 절연재료를 쓴 빌드업공법의 기술개발이 활발하다.

SVH경을 80 micron까지 극소화하여, 부품 탑재 효율을 비약적으로 향상할 수 있는 비관통형 다단접속 via hole을 채용한 다층프린트배선판도 개발되었다. 다층기판의 과제였던 through hole 안쪽 면과 전극사이의 빈틈을 해소하는 기술도 개발되어 있다.

MCM용 기판으로서는, 현재 MCM-C(ceramic기판), MCM-D(박막기판), MCM-L(plastic적층기판-프린트배선판), MCM-C/D, MCM-Si(silicon) 등이 제품화되어 있다. MCM-C 기술과 MCM-L 기술을 쓴 필름적층 방식의 박막 다층배선판도 개발되어 있다.

업계조사에서 나타난 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- 단면은 중국(한국:100, 중국:94)
- 양면 및 MLB는 대만에 비해 열세(양면 한국:100, 대만:86, MLB 한국:100, 대만:86)
- 동박 에폭시는 일본대비 다소 우위(한국:100, 일본:103)

한편 비가격 경쟁력에 있어서는 품질, 서비스 등은 대만보다 우위로 가격 경쟁력 열세를 커버하고 있으나 응용 설계능력은 대만이 우세한 것으로 나타났다.

## 3) 단기 수출촉진 대책

시장의 양극화 현상으로 전문 중견업체의 수출기반을 지속적으로 지원해야 하며 (MLB, MCM) 응용설계 기술인력 양성 확대를 위한 특별 교육 프로그램도 필요하다.

TDMA 단말기용의 수요가 예상되는 유럽시장을 집중 개척할 필요가 있다.

## 4) 수출동향 및 전망 (표 3)

### 4. 소형 모터

#### 1) 세계시장 동향 및 전망

장기적으로는 PC에서 메모리 반도체의 용량증가로 모터를 사용한 구동장치를 갖는 기존의

메모리 드라이브(FDD, HDD, CD-ROM)는 감소할 것으로 예측되지만 새로운 기기(DVD 등)의 등장에 힘입어 연간 5% 이상의 수요량의 신장이 기대된다.

21세기의 DVD-ROM 의 시장 규모는 4,000만대 가까이 달할 것으로 예상되며 CD-ROM 과 합쳐서 HDD용의 절반정도로 예측된다.

이에 따라 20배속용 이상에 사용되는 스피들 모터와 헤드 전송용으로 쓰이는 스테핑 모터의 신장이 기대된다.

## 2) 경쟁국 동향

세계 시장의 약 80%는 일본 및 일본계 해외(대만, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 홍콩 등) 생산업체가 공급하고 있다.

기술 동향은 경박단소화, 저전력화, 저소음화에 주력하고 있다.

우리나라는 생산량, 기술, 부품품 개발 등에서 모두 열세이며 업계조사에서 나타난 가격

(표 3)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	536	574	620	760	7.1	7.3	
지 역 별	미 국	168	181	195	210	7.7	3.8
	유 럽	98	128	124	160	30.6	5.7
	일 본	42	42	47	54	-	6.5
	아세아 기 타	163	159	181	245	-2.5	11.4
	65	64	73	91	-1.5	9.2	

자료 : EIAK

경쟁력은 다음과 같다.

- VTR용, FDD용 모터 등은 중국, 대만에 경쟁력 열세(한국:100, 중국:85, 대만:90)
- 휴대폰용 진동모터는 일본대비 경쟁 가능(한국:100, 일본:100)

### 3) 단기 수출촉진 대책

신규 수요(휴대폰, DVD-ROM용 등) 중심으로 규격 표준화가 시급하며 연구조합을 중심으로 기술개발 자금지원을 확대할 필요가 있다.

한편 부분품 국산화를 촉진하고 전문업체에 대한 지속적인 지원이 필요하다.

### 4) 수출동향 및 전망 (표 4)

## 5. 콘넥터

### 1) 세계시장 동향

세계시장은 10% 정도 신장이 예상되어 '98년에 264억불 정도

로 예상 된다.

지역별의 비중은 북미 38%, 유럽 27%, 일본 19%, 아시아 11% 등으로 구성되어있고 북미, 아시아 시장이 성장을 주도하고 있다.

정보기기 및 이동통신의 고도성장으로 정보기기용이 전체의 약 30%를 차지한다.

### 2) 경쟁국 동향

일본의 세계시장 점유율이 비교적 낮은 품목(약 16%)이며 기술의 동향은 점유 면적을 어떻게 삭감할 것인가를 좌우하는 커넥터의 협피치화 추세로서 피치는 표준피치(2.54mm)→하프 피치화(1.27mm)→쿼터 피치화(0.635mm)로부터 0.5~0.3mm 피치까지 더욱 발전되고 있다.

한편 SMT에 대응하여 자동실장기에 실어지는 형태와 제품의 품질도 큰 과제로 되어 있다. 보다 저 가격화를 목표로 하는 set 업체의 조립공정의 합리화에 어떻게 공헌할까, 새로운 생산기술을 염두에 둔 업체가 새

로운 제품 설계기술의 강화가 요망되고 있다.

또한 거의 모든 용도에서 EMI대응 제품의 성능향상이 향후의 과제가 될 것이다.

업체조사에서 나타난 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- FPC 콘넥터는 대만에 비해 열세(한국:100, 대만:89)
- 스테킹 콘넥터는 일본대비 우세(한국:100, 일본:141)

### 3) 단기 수출 촉진 대책

금형 개발비가 막대한 점을 고려하여 전문업체를 지속적으로 지원할 필요가 있으며 원재료 소재의 개발 및 공동 구입도 필요하다.

SMT 대응기술은 연구조합을 결성을 통한 공동개발도 필요하며 컴텍스 등 전문전시회에 참가하는 등 적극적인 해외시장 개척이 필요하다.

### 4) 수출동향 및 전망 (표 5)

## 6. 콘덴서

### 1) 세계시장 동향

수량면에서는 어느 정도 증가되나 금액 면에서는 아주 낮은 성장으로 세계시장은 3% 정도의 저조한 성장이며 전체 시장은 약 110억불 규모이다. PC, 휴대폰 등 정보기기용 수요가 주력이다.

수량기준으로는 MLCC는

(표 4)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	200	182	210	225	-9.0	5.4	
지 역 별	미 국	94	87	100	107	-7.4	5.3
	유 럽	9	9	10	11	-	5.1
	일 본	27	26	29	31	-3.7	4.5
	아세아	33	35	37	40	6.1	3.4
	기 타	37	25	34	36	-32.4	9.5

자료 : EIAK

(표 5)

(단위 : 백만불)

구분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합계	107	91	94	103	-15.0	3.1	
지역별	미국	12	13	12	13	8.3	-
	유럽	9	8	8	9	-11.1	3.0
	일본	12	11	11	12	-8.3	2.2
	아세아	44	35	37	41	-22.7	4.8
	기타	30	25	26	28	-16.7	2.9

자료 : EIAK

10% 성장, 전해콘덴서는 5.7% 성장, 탄탈콘덴서는 3.5% 성장, 금액기준으로는 전체의 약 44%를 차지하는 세라믹 콘덴서 경우 현상 유지수준이다.

## 2) 경쟁국 동향

일본계 업체의 세계시장 점유율은 46% 정도이다. set 업체의 가격에 대한 요구, 일부의 공급과잉, 일본의 동남아 생산기지 확대 특히 일본계 생산의 약 50%를 차지하는 중국의 생산증가 등으로 대부분의 제품에서 전반적으로 단가 하락이 추세이다.

기술적으로는 SMT에 대응하는 Chip화의 급진전(탄탈의 경우 약 20% 예상)이 진행되고 있다. 특히 고 용량화, 고 정밀화로 각기의 고유영역이 무너지면서 경합이 치열하다.

트림머 콘덴서 : 이동체 통신 단말에서의 TCXO(온도보상형 수정발진기) 등의 온도보상 회로의 주파수 조정 용도로 소형

화 요구가 활발하고, 칩 트림머 콘덴서로서는 지금까지 3형 chip이 주류이었지만, 최근에는 2형 chip도 개발되고, 또한 초박형 칩이 실용화되었다. 이 초박형 chip은 높이도 약 1.3 mm로 억제되고 있고, 20 pF의 고 용량화를 실현하고 있다.

chip 알루미늄 전해 콘덴서 : 실장면적의 성 space화, 각 chip은 높이 방향의 고밀도화에 대응하여, 실장형태에 의해 사용되고 있다. 모두 저 임피던스 사양이고, 105°C 대응, 무극성, 대용량형 등 제품 다양화를 충실히 하고 있다.

또 하나의 움직임은 전해질의 고체화이다. 고체 전해질은 이산화망간을 이용한 무기 전해질과 폴리피롤 등의 유기 전해질로 크게 구별되지만, 모두 저 임피던스와 장수명화를 추진하는 기술이고, 전원의 평활 콘덴서 등으로 시장을 확대하고 있다.

적층 칩 세라믹 콘덴서 : 최소 크기로서 이미 1×0.5 mm 크기까지 극소화되었다. 또 한

편으로는 소형화하면서 대용량화와 고압화 기술이 진전하고 있다. 특히 대용량화에 있어서는 저온 소결 세라믹을 이용한 박층화 기술에 의한 다층구조의 생산기술이 확립되어 탄탈, 알루미늄 전해의 영역에까지 침투하고 있다.

은-파라듐이 일반적인 전극이지만, 최근에서는 소형 대용량화와 저 가격화를 추진하기 위해서 내외부전극에 니켈계 금속을 이용한 제품도 양산되고 있다. 복수개의 콘덴서를 1개의 칩 콘덴서로 제조하는 에레이화의 움직임도 표면화되고 있어서 개개의 콘덴서의 실장 부품 수를 줄이고, 고밀도 실장에 기여하는 기술로서 디지털 회로에서 주목되고 있다.

칩 탄탈콘덴서 : 고 CV 탄탈분말의 사용과 구조의 개선 등에 의해, 비약적인 소형 대용량화가 실현되었다. 크기는 2×1.25 mm으로 이동하였고, 같은 크기로 10μF/6.3V의 대용량품이 등장하였다.

더욱이 저 임피던스화, 고 리플화를 소형대용량화와 동시에 실현하기 위해서, 이산화망간에 대신해 음극재료로 폴리피롤을 이용한 기능성 고 분자형도 이미 3.2×1.6 mm 크기의 양산이 시작되고 있다.

칩 필름 콘덴서 : 칩화율은 낮지만, 2×1.25 mm까지 소형화가 실현되는 한편, 중고압화 기술이 진전하고, LCD의 back light용 inverter unit에서의 탑재가 정착되어 가는 등, 서서히

시장범위가 확대되고 있다.

필름 콘덴서는 전원용, 중고압화, 음향용이 주된 시장이지만, 그 중에서 전원용에서는 metallized 기종에 있어서의 공진용, noise 대책용, active filter용 등으로 신제품의 개발이 활발하다.

칩 마이카 콘덴서 : 정전용량 허용차가 작고, 고주파 특성에 우수한 것을 특징으로 통신 기기 분야를 주력으로 하고 있는 칩 마이카 콘덴서는 2×1.25mm 크기로부터 1.6×0.8mm 크기로 소형화가 진행되고 있다.

업계조사에서 나타난 가격 경쟁력은 일본에 비해서 다소 우세지만 MLCC는 대등한 수준이다. 특히 수입의존(MLCC, 전해콘덴서 등) 원자재가 가격 경쟁력 확보에 애로사항이다.

- 전해콘덴서 한국:100, 일본:106
- MLCC 한국:100, 일본:100

### 3) 단기수출 촉진 대책

전문업체의 기술개발을 지속적으로 지원하여 Chip화, SMT, 박막기술 채용 등에 대응할 필요가 있다.

특히 MLCC는 가격 경쟁력 제고를 위한 부분품 국산화, 신기술개발 (Ni전극) 등의 지속적인 지원이 필요하다.

한편 적극적인 해외, 특히 미국시장 개척을 위하여 해외 인증규격 획득 등 품질 및 신뢰성 제고노력도 요구된다.

### 4) 수출동향 및 전망 (표 6)

## 7. 자기테이프

### 1) 세계시장 동향

세계시장은 1% 정도의 낮은 성장으로서 디스크, CD화와 결합하는 오디오용은 1% 감소하며 비디오용은 3% 정도 증가 추세이다.

디지털 VCR용은 표준규격에 합의하는 등 신수요의 여건이 조성되고 있는 상황이다.

### 2) 경쟁국 동향

한국의 세계시장 점유율이 50% 차지한다. 기술개발은 테이프의 박형화, 자성층의 고밀화 등을 중심으로 진행되고 있다.

업계조사에서 나타난 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- 저급품은 중국, 홍콩에 비해 열세 (한국:100, 중국:90)

- 고급품은 일본에 비해 다소 우위지만 비가격 경쟁력 면에서 열세

비가격 경쟁력면에서는 특히 일본은 H/W시장과 연계하는 판매전략으로 브랜드 이미지면에서 우세하다.

### 3) 단기 수출촉진 대책

단가 하락 방지 협의회를 중심으로 해외시장에서 국내업체 간 과당경쟁을 지양해야하며

디지털 VCR용 등 신수요의 개발이 촉진되어야하며 광자기디스크 등 대체 매체를 중점 개발할 필요가 있다.

### 4) 수출동향 및 전망 (표 7)

## 8. 스피커

### 1) 세계시장 동향

세계시장은 수량면에서 4.3% 성장(세계시장 규모는 '98년 47

(표 6)

(단위 : 백만불)

구분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감율(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합계	346	337	356	417	-2.6	5.5	
지역별	미국	35	38	38	45	8.6	4.3
	유럽	48	59	56	65	22.9	2.5
	일본	29	23	27	32	-20.7	8.6
	아세아	158	143	157	184	-9.5	6.5
	기타	76	74	78	91	-2.6	5.3

자료 : EIAK

(표 7)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	859	721	732	750	-16.1	1.0	
지역별	미국	241	215	211	216	-10.8	0.1
	유럽	103	103	95	98	-	-0.1
	일본	132	109	112	114	-17.4	1.1
	아세아 기타	152	134	133	136	-11.8	0.4
		231	160	a181	186	-30.7	3.8

자료 : EIAK

억6백만개) 하였으나 단가 하락 추세로 금액으로는 현상유지 내지 다소 감퇴되고 있다. 대만 등의 저가 공세로 단가 하락세는 당분간 지속될 것으로 예상된다. PC, 휴대폰용이 수요증대를 주도한다.

향후에는 PC의 멀티미디어용, 또는 게임기, MD등 새로운 장르의 시장이 확대하고 있으며 향후 가정극장(홈시어터) 등의 새로운 분야도 형성될 기미가 보이고 있다.

2) 경쟁국 동향

AV분야에서는 고음질용 진동판 재료(액정 polymer, super - graphite, 해산물로부터 추출한 소재:chitin, 호야, 다시마 등)의 개발이 활발하여 고음질 지향의 요구에 대응하고 있으며 압전형 스피커의 소형화, 박형화, 고음질화로 기존 제품 수요 잠식도 예상된다.

업계조사에서 나타난 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- 컴퓨터, 자동차용은 대만대비

열세  
(컴퓨터용 한국:100, 대만:79)  
(자동차용 한국:100, 대만:89)  
- TV용은 중국과 대등  
- 헤드폰용은 일본대비 우세  
(한국:100, 일본:125)

3) 단기 수출촉진 대책

연구조합 중심으로 부분품 개발이나 업계 공동수입 추진이 필요하다.

압전 스피커, 이어폰용 등 고부가가치 제품개발에 의한 수출 확대가 요구되며 전문업체의 개발지원을 지속하여 기술개발을

촉진해야 한다.

4) 수출동향 및 전망 (표 8)

9. 저항기

1) 세계시장 동향

세계시장은 수량면에서 5% 정도 증가( '98년 시장규모 810억개)가 예상되지만 금액 면에서는 20%정도 감퇴될 것으로 예상된다.

수량 증가는 Chip형,특히 이동통신용이 (년평균 10% 정도) 주도하고 있다. 금액 면에서는 대만, 중국 등의 저가 공세로 하락세가 지속될 것으로 예상된다.

2) 경쟁국 동향

기술적으로는 극소 Chip화 (1608형 → 1005형), 다련 Chip화(1608형 2련 → 4련), 박막 Chip화(고주파화, 극소 Chip화, 무조정화)가 추세이다.

(표 8)

(단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감율(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	188	152	122	195	-19.1	6.4	
지역별	미국	36	33	25	20	-8.3	-11.8
	유럽	28	24	19	26	-14.3	2.0
	일본	37	27	23	30	-27.0	2.7
	아세아 기타	38	20	21	35	-47.4	15.0
	49	48	34	84	-2.0	15.0	

자료 : EIAK

업계 조사에 의한 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- 범용은 중국, 대만 대비 열세 (한국:100, 대만:75)
- Chip형은 일본과 대등한 수준이나 비가격 경쟁력 면에서 열세

3) 단기 수출촉진 대책

Chip형, Network 저항기 등이 동통신용 수요중심으로 시장 개척에 나설 필요가 있으며 전문업체의 기술개발을 지속적으로 지원하여 극소 Chip화, 다련 Chip화, 박막 Chip화 추세에 대응해야하며 부분품 공동개발

및 공동구매 추진을 위한 연구 조합 결성도 필요하다.

4) 수출동향 및 전망 (표 9)

10. 변성기

1) 세계시장 동향

세계시장은 약 5% 정도 증가가 예상되며 품목별로는 DY, FBT는 정체되어있고 PC카드 모뎀용, SMD형 고주파 칩인덕터, 노이즈 대책용, LCD의 back light용 인버터 등은 수요 증가 추세이다.

2) 경쟁국 동향

기술적으로는 CAD에 의한 최적 설계 기술 등 SMD화 기술의 진전으로 노이즈 대책용 코일이나 트랜스에 있어서 모두 극소 Chip화(적층화, 1005 Chip) 추세이며 LCD의 back light용 inverter용 트랜스는 특히 박형화를 강화하고 있어, 코일형의 박형화 노력 외에 압전 ceramic를 이용한 코일 less의 압전 트랜스를 상품화하여 초박형화를 실현하는 업체도 출현하였다.

업계조사에 의한 가격 경쟁력은 다음과 같다.

- FBT용은 대만대비 열세(한국:100, 대만:89)
- 노이즈 필터용도 대만대비 다소 열세 (한국:100, 대만:101)
- DY 코아, 오디오용 트랜스는 일본대비 우세 (한국:100, 일본:110~125)

3) 단기 수출촉진 대책

전문기업의 기술개발 지속지원으로 Chip화, SMD화에 대응해야하며 특히 LCD용 인버터, 휴대폰용 SMD 트랜스 등 고부가가치형 제품을 중점 개발할 필요가 있다.

한편 PL법 도입에 대응하여 안전대책 강화도 필요하다.

4) 수출동향 및 전망 (표 10)

(표 9) (단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	88	69	72	80	-21.6	3.8	
지역별	미 국	7	7	6	6	-	-3.8
	유 럽	6	5	5	5	-16.7	-
	일 본	8	3	5	5	-62.5	13.6
	아세아	32	23	28	30	-28.1	6.9
기 타	35	31	28	34	-11.4	2.3	

자료 : EIAK

(표 10) (단위 : 백만불)

구 분	'97	'98	'99 (전망)	'01 (전망)	증감률(%)		
					'97/'98	'97/'01	
합 계	78	74	70	77	-5.1	1.0	
지역별	미 국	4	5	4	5	25.0	-
	유 럽	10	13	11	12	30.0	-2.0
	일 본	23	19	20	20	-17.4	1.3
	아세아	30	25	26	30	-16.7	4.7
기 타	11	12	9	10	9.1	-4.5	

자료 : EIAK